

2012年2月17日

PIM(Powder Injection Molding)事業の取り組みについて

2012年2月10日付第3四半期決算短信及び2012年2月13日付第3四半期報告書でも触れておりますが、PIM(Powder Injection Molding)事業で取り組んでおりますバインダの販売につきまして、ご報告いたします。

PIMとは粉末射出成形の略で、金属やセラミックなどの微粉末を高分子を主成分とするバインダと混合し金型で射出成形した後、加熱炉で焼結して金属製品、セラミック製品をつくりだす技術です。当社はバインダ材料の開発から製品の製造まで一貫して行う技術を有しています。

当社はこの技術を生かし、現在市場が拡大しており今後の成長が見込まれるスマートフォン、タブレット型端末分野での事業拡大をめざし、マーケティング活動を強化しています。

現在、当社PIM事業において、金属やセラミックの粉末を射出成形する際に流動性を付与するために不可欠な成形助剤であるバインダを中心に出荷しております。当社が製造・販売しているバインダは、その成形性の良さと最終部品表面の鏡面性が高く評価され、スマートフォン・タブレット型端末の外観部品成型用に複数のPIM成形メーカーへの納入が始まっております。

当社では、PIM用バインダを、成形、焼結等のプロセス毎に様々な要求に応えられるラインアップを増やし、今後も引き続き開発上市してまいります。

以 上